



# BUSINESS REPORT 2018

**FUJIMI**

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

# 社長あいさつ



平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2018年3月期の当社グループを取り巻く環境は、世界各国において政治・政策面での先行き不透明感が残っているものの、米国経済は景気回復が持続し、日本・欧州経済は緩やかな景気回復に向かい、中国では景気持ち直しの動きがみられました。また、世界半導体市場は、ロジックデバイス、メモリデバイスともに堅調な需要に支えられ、好調に推移しました。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めました結果、2018年3月期の業績は、売上高35,788百万円（前期比8.1%増）、営業利益4,872百万円（前期比13.9%増）、経常利益4,728百万円（前期比4.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失として有形固定資産（土地、建物等）の減損損失を計上したこともあり3,011百万円（前期比10.1%減）となりました。

当期のトピックスとしましては、CMP製品の売上高が14,621百万円となり、3年連続で最高売上高を更新しました。これは、半導体市場の好調を背景に最先端ロジックデバイス・メモリデバイス向け製品の販売が好調に推移したことによるものです。また、米国においては、インテル社よりプリファード・クオリティー・サプライヤー（PQS）賞を受賞しました。現在、次世代半導体デバイス用に研磨材の生産体制を整備しており、お客様の急な需要の立ち上がりには備えております。

その他、金属とセラミックを複合させた新規材料（超硬合金粉末）の開発と積層造型技術に関する研究を加速するため、高機能金属3Dプリンターを導入しました。3Dプリンターの材料は樹脂や金属が主流ですが、超硬合金粉末を用いることで、従来の金型に比べ軽量で製作コストと時間を低減できるため、今後の普及が見込まれております。

最後になりますが、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）ファンドにおいて、2015年11月の設立からこれまでにベンチャー企業4社への投資を実行しました。出資先の選定は当社が得意とする分離技術や研磨技術をともに進めてゆけるベンチャー企業などです。当社コア技術とのシナジーを創出し、事業の更なる拡大と新規事業の機会探索に繋げてまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2018年9月  
代表取締役社長

## 関 敬史

## プロフィール

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP（化学的機械的平坦化）、ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。なかでも、主力事業分野である半導体基板向け超精密研磨材では世界ナンバーワンのマーケットシェアを維持しており、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、市場優位性を維持しております。

## 目次

社長あいさつ	1
経営方針	3
中長期経営計画	5
事業紹介	7
暮らしの中のフジミ	13
製造工程の中のフジミ	15
経営指標	17
連結貸借対照表	19
連結損益計算書	21
連結包括利益計算書	21
連結キャッシュ・フロー計算書	22
沿革	23
株式情報	24
会社データ	25

# Message from the President

In the FY2018 (April 2017-May 2018), despite ongoing political uncertainty, the US economy continued to be strong, Japan and Europe experienced a gradual economic recovery, and China began seeing a slight recovery. Furthermore, the global semiconductor market grew due to increased demand for logic and memory devices.

The consolidated results for this period are shown below. Net Income attributable to owners of parent decreased due to an impairment loss on plant fixed assets in extraordinary losses.

FY2018 Consolidated Results:	Millions of JPY		
	FY ended March 31, 2017	FY ended March 31, 2018	Change YoY
Net Sales	33,092	35,788	8.1%
Operating Profit	4,278	4,872	13.9%
Ordinary Profit	4,519	4,728	4.6%
Profit Attributable to Owners of Parent	3,350	3,011	(10.1%)

Highlights for the fiscal period include sales of chemical mechanical planarization (CMP) products totaling JPY 14,621 million, the highest sales to date for the third consecutive year. The basis for this comes from the favorable sales of products for leading-edge logic and memory devices, reflecting favorable conditions in the semiconductor market. Also, we received the Preferred Quality Supplier (PQS) Award from Intel Corporation. Currently, we are improving the production systems for abrasives meant for next-generation semiconductor devices, and we are preparing for sudden rises in customer demand.

In order to accelerate research on the development of new materials (cemented carbide powders) composed of metal and ceramics and research on laminated molding technology, we introduced high-performance metal 3D printers. While resin and metal are common materials for 3D printers, by using cemented carbide powders, it becomes possible to create molds that are lighter than conventional molds, reducing manufacturing costs and required time. We therefore expect this to be adopted in the future.

Finally, regarding the CVC (Corporate Venture Capital) Fund, we have invested in four venture companies so far since its establishment in November 2015. Venture companies that have the ability to advance separation and polishing technologies were selected for investment, areas in which we excel. We will create synergy with our core technologies to further expand our business and explore new business opportunities.

We are grateful for your patronage and ask for your continued understanding and support.

September 2018

Keishi Seki, President

## Profile

Drawing on the know-how and R&D capabilities the Company has accumulated since its founding, the Company has developed numerous products essential for leading-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (chemical mechanical planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and hard disk polishing. In particular, the Company holds the top global market share for high-precision abrasives for semiconductor substrates, a core business area, and the Company maintains its market superiority as the leading name in synthetic precision abrasives.

## Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Medium & Long Term Business Plan	6
Business	8
Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	13
Fujimi's Products in Manufacturing Process	15
Selected Financial Data	17
Consolidated Balance Sheet	19
Consolidated Statement of Income	21
Consolidated Statement of Comprehensive Income	21
Consolidated Statement of Cash Flows	22
History	23
Stock Information	24
Corporate Data	25

# 経営方針

## はじめに

当社は「パウダー&サーフェス分野」を事業領域として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の品質化と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術の高度化に対して、迅速かつ的確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

## 企業理念

### 企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

### 経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・一人ひとりが「働きがい」と「働きやすさ」を実感できる会社を目指します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

### 行動規範

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・一人ひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

## 企業ビジョン

### 事業アイデンティティ

パウダー&サーフェス分野で世界最高技術を提供し、理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

### 企業文化ビジョン

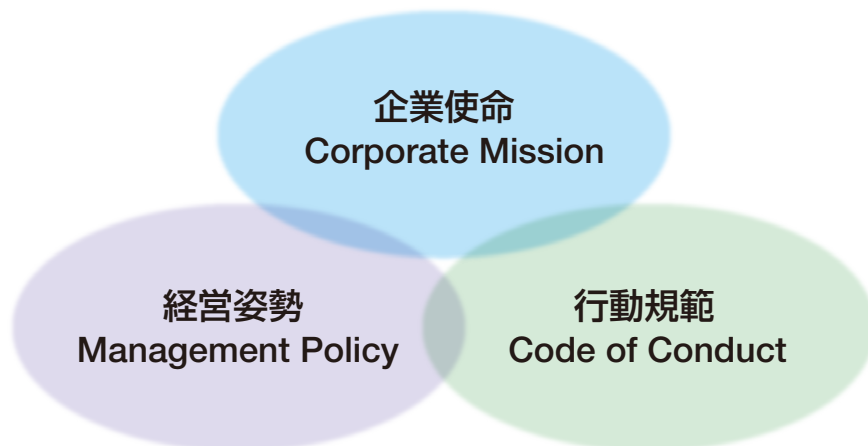
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいただき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

### 事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

## 企業理念 Corporate Philosophy



# Management Objectives

## Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered in powder and surface fields. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality products, a manufacturing approach from which we have

never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain same.

## Corporate Philosophy

### Corporate Mission

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

### Management Policy

- We adopt the customer's point of view to create solutions that meet the customer's needs and expectations.
- We aim to be a company that motivates employees to excel by creating a great work culture.
- We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders' confidence and trust.

### Code of Conduct

- We act with customer satisfaction in mind.
- We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- We respect each person's ideas.
- We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

## Corporate Vision

### Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing environmental impact as a member of a recycling-based society.

### Corporate Cultural Vision

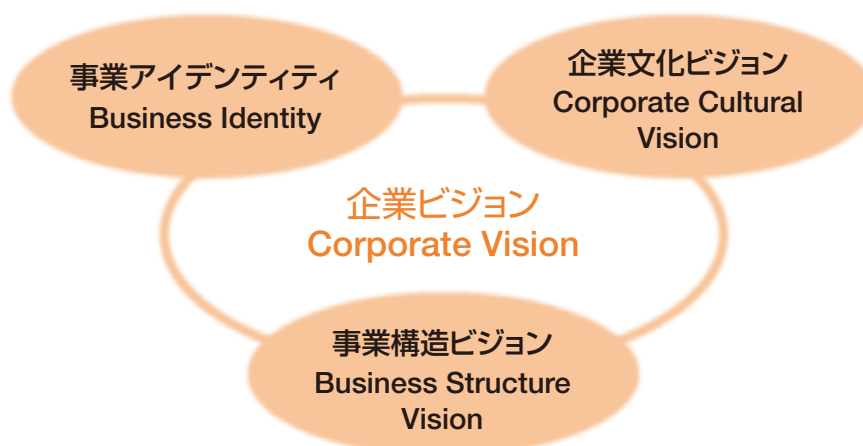
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

### Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (Silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

### 企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision



# 中長期経営計画

2016年11月に新たな中長期経営計画を策定し、中長期ビジョンに「私たちは一人ひとりの前向きなアイデアとチャレンジを応援します」を据えました。これは、社員一人ひとりから自発的なアイデアとチャレンジが次々と生まれ、それを育む土壌を整えることで、環境の変化に対応し、企業文化ビジョンに掲げた「強く、やさしく、面白い」会社に向かっていくことを意図したものです。

当社はこれまで半導体市場を主たる事業領域とし、主に精密研磨材を開発・製造・販売してまいりましたが、事業環境の変化は激しさを増しています。長らく半導体市場の主役であったパソコンは2012年以降出荷台数の減少が続いており、その後市場を牽引してきたスマートフォンも既に成長率は大きく鈍化し、ポストスマートフォンに向けた新たな業界再編の動きが活発化しております。

こうした事業環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要であると考え、非半導体関連売上構成比の向上を目指してまいりました。一方で、当社は2012年に事業ドメインを「パウダー&サーフェス」と定めましたが、実際のところは従前同様に研磨材を中心とした事業活動が軸となっております。

中長期経営計画では、「ろ過・分級・精製技術」「パウダー技術」「ケミカル技術」からなる当社のコア技術を活かし、「パウダー&サーフェス」に加え、「表面加工のソリューション」へ事業ドメインの拡大を目指してまいります。具体的な取り

組みとしては、短期から中期的には既存事業での深掘りと周辺領域の新規用途開拓を進め、中期的には「パウダー&サーフェス」を意識した非研磨用途・事業を拡充し、さらには10年先を見据えた長期視点での育成を進めてまいります。

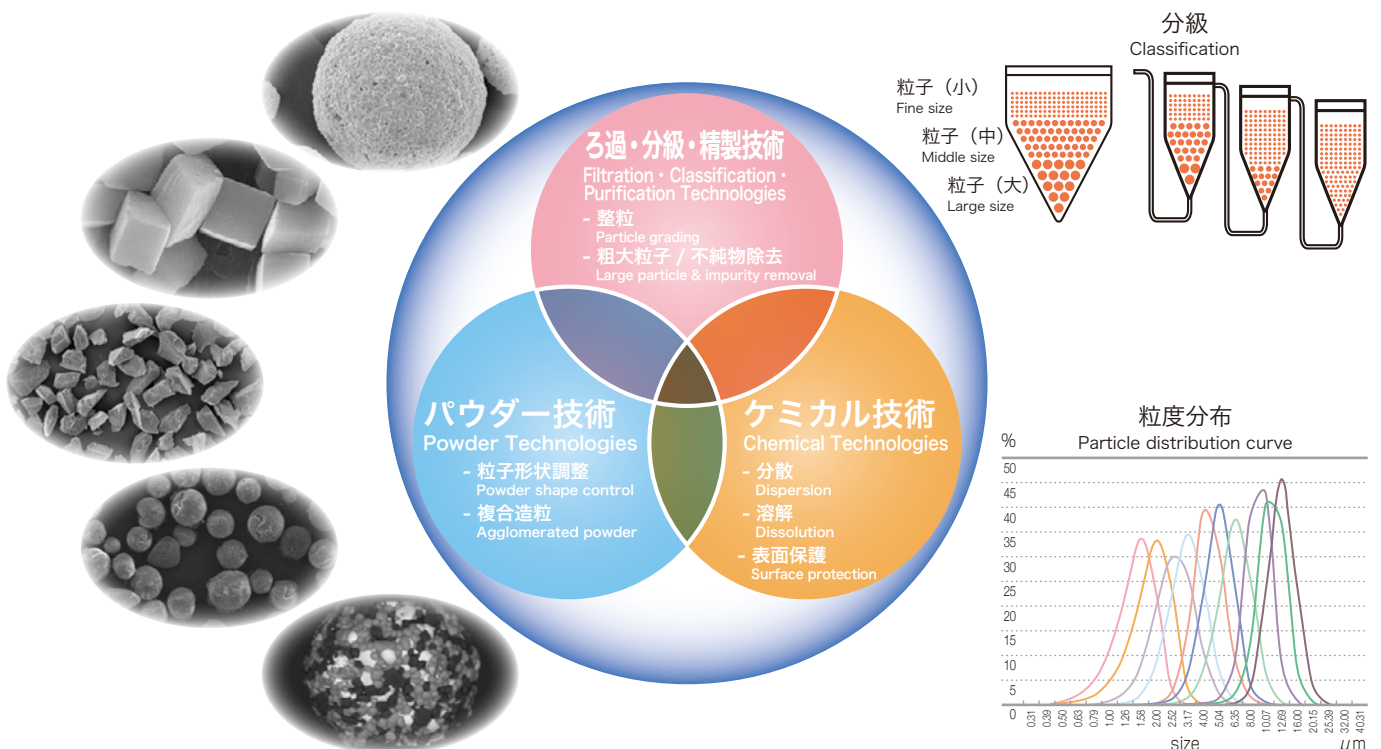
なお、長期視点の活動につきましては、2015年4月に先端技術研究所を設置し、既に取り組みに着手しております。これまで築き上げた強固な財務基盤を背景として、引き続き成長のための積極的な開発投資を行ってまいります。

上記取り組み成果を測る指標として、非半導体売上構成比に加え、新規事業売上構成比、非研磨分野売上構成比についても目標を定め、定期的に進捗管理を行うことで、安定的かつ持続的な成長に繋げてまいります。

また、成長分野への積極投資と併せ株主の皆様への還元を強化（配当性向を50%以上）することで資本効率（ROE、ROA）を高めると同時に、CSR活動においては、これまでの活動に加え、両立支援、女性活躍推進等にもより一層力を注ぎ、企業価値増大を目指してまいります。

## 当社のコア技術

### Fujimi's Core Technologies



# Medium & Long Term Business Plan

In November 2016, we drew up a new Medium & Long Term Business Plan and set our Medium & Long Term Vision as “We support your forward-looking ideas and challenges.” This comes with the intent of striving towards a company that is “Strong, Kind and Exciting,” as stated in our Corporate Cultural Vision. This is realized by adapting to the changing environment made possible by cultivating the space for the growth of the voluntary ideas and challenges of each individual employee.

Until now, we have mainly developed, produced and sold precision abrasives with the semiconductor market as our main business area. However, the changing business environment is only getting more severe. Personal computers that have long been the key player of the semiconductor market, have seen a decline in shipments since 2012, and even smartphones that have held up the market since have seen a large slowdown in growth. Currently, there is increasing activity in industry reorganization in preparation for the post-smartphone era.

We believe a business structure that does not lean towards specific markets or needs is crucial in order to attain a stable and continued growth in such a business environment, and have thus aimed to improve our sales distribution ratio of non-semiconductor related items. On the other hand, although we established our business domain as “powder and surface” in 2012, in actuality, most of our activity was centered around abrasives as seen previously.

With the Medium & Long Term Business Plan, we aim to

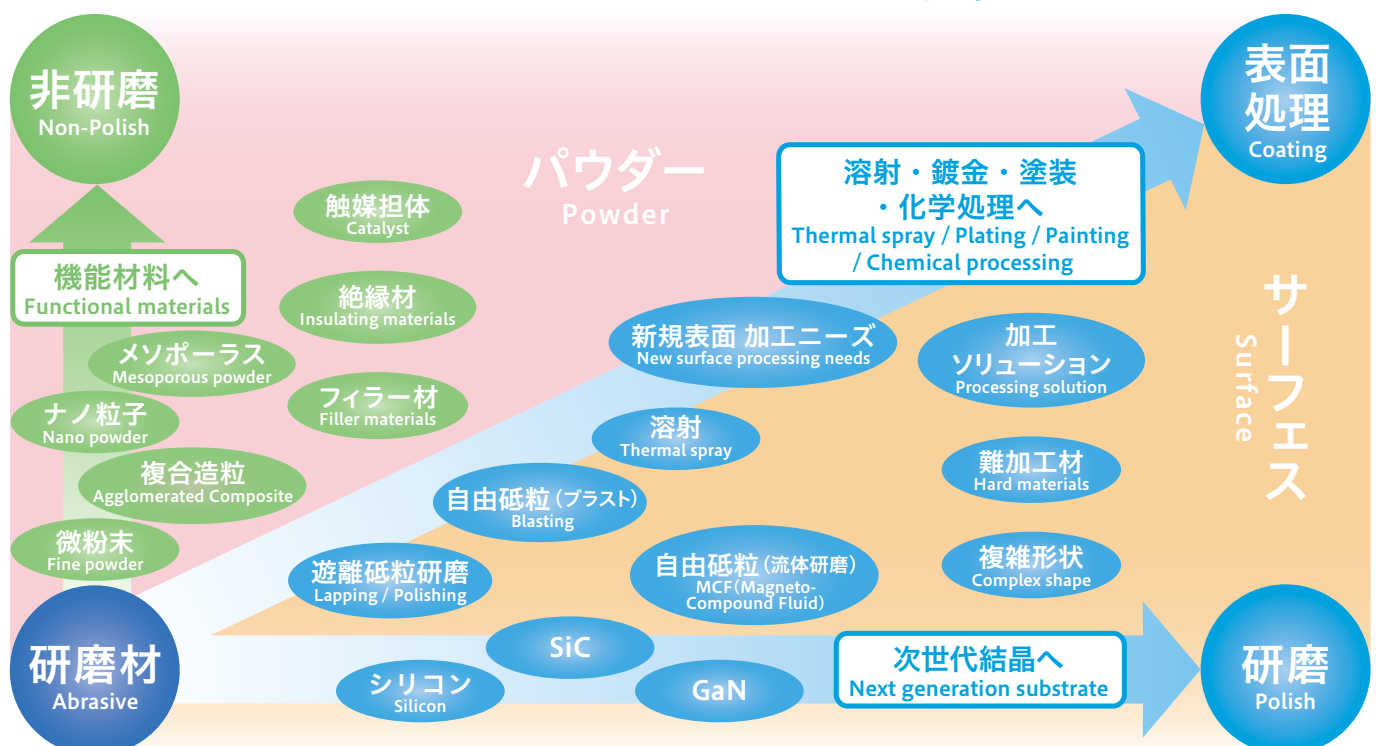
expand our business domain to “polishing solutions” in addition to the current “powder and surface” area by our core technologies; filtration, classification, and refinement technologies, powder technologies, and chemical technologies. In the short to mid term, we will expand existing business and develop new application of peripheral areas, while in the mid term, we will expand the application and business of non-polish with “powder and surface.” Furthermore, we hope to continue this growth with the long term, even 10 years.

Also, we have begun working on long term activities by setting up the Advanced Technology Research Center in April 2015. We will continue proactive development investments to achieve continuous growth with our solid financial base.

As an index for measuring the success of the above endeavors, we are striving for stable and continuous growth by periodically managing progress through setting goals for the sales distribution ratios for new businesses and the sales distribution ratios for non-abrasive areas, on top of those of non-semiconductors.

We will strive to largely increase our corporate value by strengthening the return to our shareholders coupled with our active investments in growing areas (over 50% payout ratio), increase capital efficiency (both ROE and ROA), and place more effort into promoting female activity and work-parenting support as part of our CSR activities.

## 研磨材メーカーから「パウダー & サーフェスカンパニー」へ Conversion from Abrasive Manufacturer to “Powder & Surface Company”



# 事業紹介

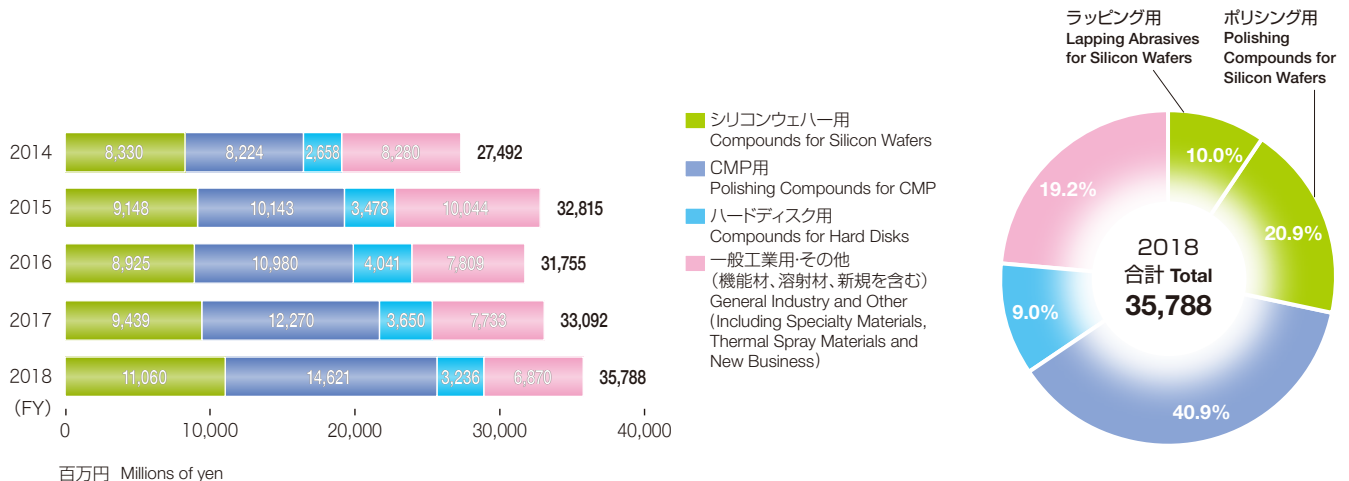
当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長の鍵となる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査探索機能の強化に努めております。

当社の各事業と先端技術研究所をご紹介します。

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

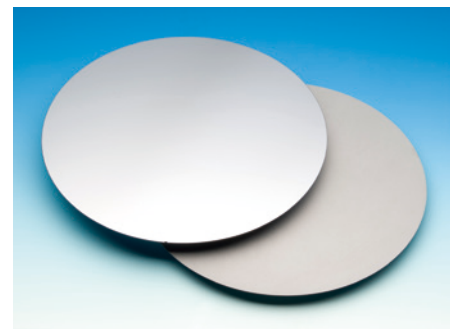
## 用途別製品売上高 Sales by Application



## シリコン事業

### 事業概要

半導体基板となるシリコンウェハーを高精度に平坦・鏡面化する研磨工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。切断から仕上げ研磨まで高品質な製品・サービスを揃え、高度化するお客様の要求に応じております。引き続き新技術に支えられた独自性の高い新製品を提供し、「最も信頼されるパートナー」を目指してまいります。また、近年注目されているパワーデバイス基板向け製品開発にも注力し、一部上市しております。



### 研究開発活動

300mm シリコンウェハーの需要拡大、デザインルールの微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①高平坦化、②高平滑化、③無欠陥化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっております。

高平坦化や生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工力、加工精度および加工歩留まり向上を共に満足する製品の開発を進めております。

一次研磨工程用スラリーとしては、ウェハー中心部から最外周部まで超平坦に加工できる差別化製品から、高速研磨型やリサイクル性付与型等お客様の生産性向上につながる製品までを、また、最終仕上げ研磨工程用スラリーでは、配線間隔が10nm台のウェハー研磨用として研磨後表面のナノ欠陥を激減し原子レベルの平滑性を実現するポリシング材の開発を、砥粒・添加剤設計、配合技術を応用しながら取り組んでおります。

さらには、近年次世代パワーデバイスとして SiC や GaN 系の半導体が注目されております。これら難加工基板用研磨材の研究開発も進めており、高速・高面質となる新たな製品・プロセス開発に取り組んでおります。

# Business

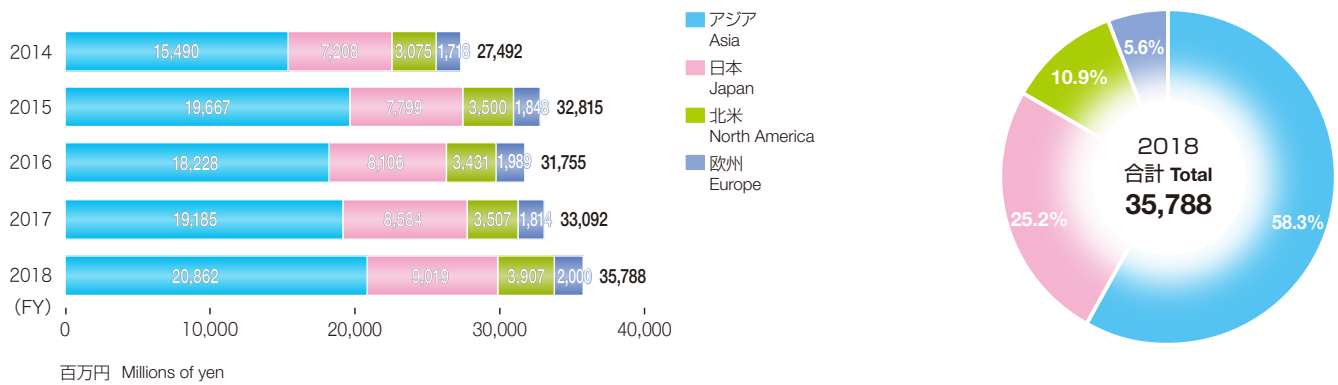
As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks.

Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is the key of our growth. We are working to strengthen our research and exploring functions on technology-based new business and topics.

We introduce each business and Advanced Technology Research Center.

3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

## 地域別売上高 Sales by Region



## Silicon Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the high-precision polishing process in which silicon wafers, which become semiconductor substrates, are flattened and mirror polished. We offer high-quality products and services for every step of the process from cutting to polish finishing, satisfying the increasingly sophisticated requirements of our customers. We aim to become our customers' "most trusted partner" by continuing to provide highly distinctive new products supported by new technologies. In addition, we are focusing on the development of products for power device substrates, which have received attention in recent years, and have put some of these products on the market.

### Research and Development Activities

As there is an increase of demand for 300mm silicon wafers in the market, as well as a further shrinking of design rules, requirements of super precise polishing for 1) high flatness, 2) low roughness, 3) defect free, 4) metal contamination free and 5) productivity improvement are getting stronger and stronger.

For the application of silicon lapping and slicing abrasives, for which high flatness and high productivity are needed, we are proceeding with activities to satisfy the cutting rate, quality and yield for customers.

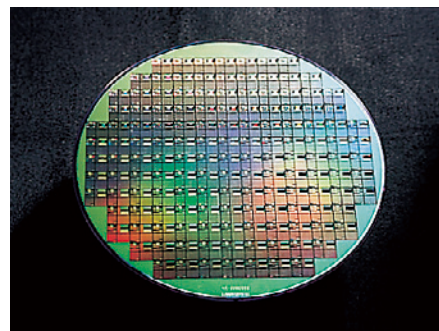
For the application of silicon stock polishing slurry, we are exclusively developing new products, not only to produce a super flat silicon wafer from the wafer center to the furthest area on the periphery, but also to enhance the productivity for customers through a high stock removal rate and longer recyclable slurry. And for the application of the final polishing slurry to meet a 10nm level node, we are also developing new products that can reduce nanometer-sized defects drastically and improve the atomic level roughness after polishing based on abrasive/additive design and formulation technology.

Furthermore, SiC and GaN semiconductors have recently been focused on as next-generation power devices. We are proceeding with R&D activities on the slurry for such a hard material and are working to develop a new product/process for a high removal rate with a high surface quality.

## CMP事業

### 事業概要

半導体デバイスの製造工程で用いられる研磨材を製造販売する事業です。半導体デバイスは高性能化、高密度化、高集積化に伴い、CMPが適用される工程は増加傾向にあります。お客様の製造・開発拠点に近い、日本、米国、台湾に製造・開発拠点を設け、お客様とより密接な関係を構築し、お客様のロードマップに沿った新製品を開発しております。また、成長が期待される中国市場に対しても、開発および販売活動を強化しております。



### 研究開発活動

先端の半導体デバイスの微細化が進展し、ロジックデバイスではテクノロジーノード10nmのデバイスが量産化され、7nm以降のデバイスの研究開発が活発化しております。微細化の進展に伴い、Fin FETと呼ばれる3次元構造のトランジスタが使われています。また、NAND型フラッシュメモリにおいては3次元に積層し、高密度化した3D NANDと呼ばれるフラッシュメモリの量産が拡大しております。さらには、DRAMや異種のデバイスを3次元に実装するためにスルーシリコンビア (TSV) 技術の量産適用もされています。これらの新トランジスタや新構造の形成においても、CMPプロセスが適用され、その用途はますます広がりつつあります。

当社では、多結晶シリコン薄膜用やCu配線形成用にポリシング材を開発しておりますが、上記のようなCMPプロセスの用途拡大にあわせ、新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めております。微細化、高密度化とともに高度化するお客様の要求にお応えするため、当社では最先端の研磨装置、評価装置、分析装置を活用すると同時に当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っております。

## ディスク事業

### 事業概要

パソコンやサーバー、ゲーム機、高画質レコーダーなどの記録媒体であるハードディスク用基板の製造工程に用いられる研磨材を製造販売する事業です。お客様の生産拠点が集中するマレーシアに製造拠点を置くとともに技術スタッフを配置し、技術サポートを実施することでお客様との信頼関係を構築しております。また、次世代ディスク基板への要求を早期に入手し具現化するため基礎開発の拡充も図り、お客様の要求に合った新製品をタイムリーに提供してまいります。



### 研究開発活動

増大していくデジタルデータの保存要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速されています。現在、ハードディスク基板はナノレベルの欠陥が問題とされており、欠陥数および欠陥サイズの低減要求はさらに厳しくなっております。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動により新製品の開発を推進しております。

## 機能材事業

### 事業概要

電子部品、自動車、レンズ等に使用される精密砥石、研磨布紙およびラッピング・ポリシング・ブラスト向けの研磨材と充填剤等として使用される機能性材を製造販売する事業です。粒子形状・粒度分布制御を始めとするパウダー技術を活かし、お客様のご要望に的確な対応をすることにより潜在的なニーズまでも引き出し、さらに信頼を高めてまいります。また、砥粒の新たな用途についても技術力を強化し、探索を進めております。

### 研究開発活動

LT/LN、プラスチックレンズ、ガラスなど多種多様な表面に適した研磨材および原材料となる微粒子の開発に取り組んでおります。お客様のご要求を的確に捉え、当社のコア技術を活用してお客様にご満足いただける製品の開発を推進しております。

## CMP Business

---

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the manufacturing process of semiconductor devices. CMP is increasingly used in the manufacturing process of semiconductor devices as they have become more highly-functional and highly-integrated products with higher density. We have established manufacturing and development bases in Japan, the United States, and Taiwan, which are located near the manufacturing and development bases of our customers, thereby building closer relationships with customers and developing new products in accordance with customers' roadmaps. Additionally, we are reinforcing development and sales activities in Chinese markets, which are expected to grow in the future.

### Research and Development Activities

As the shrinking of leading-edge semiconductor devices is progressing, the mass production of 10nm technology nodes for logic devices and the research and development for devices smaller than 7nm are actively moving forward. Alongside the shrinking trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, is being used. Also, the NAND flash memories are now laminated in 3 dimensions, while mass production for further high-density flash memory called 3D NAND is expanding. Furthermore, Through Silicon Via (TSV) technology that mounts DRAM and other types of device in 3 dimensions has already moved into mass-production. The CMP process is applied to forming these new transistors and new architectures as well with the strong prospect of expanding its use.

Although we have already developed slurries for polycrystal silicon films and Cu wiring, we have also launched development of slurries that can be used with new materials and structures to expand the use of the CMP process as mentioned above. We are employing state-of-the-art polishing, evaluation, and analysis equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer requirements for higher levels of shrinking densification and sophistication.

## Disk Business

---

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives that are used in the manufacturing process of substrates for hard disks, which are storage media for devices such as personal computers, servers, video game consoles, and highdefinition recorders. We have a manufacturing base in Malaysia, in which our customers' production bases are concentrated, and we have built relationships of trust with our customers by allocating technical staff and providing technical support in the region. In addition, we endeavor to expand the areas of basic development in order to grasp customers' requirements for next-generation disk substrates at an early stage, thereby promptly providing new products that meet customers' requirements.

### Research and Development Activities

The development of next generation hard disks has been accelerated for the required storage of increasing digital data. Today, the requirements for fewer and smaller defects are getting severer than ever, as nanometer-level defects are considered problems for the hard disk substrates. To meet these requirements, we have been driving new product developments through activities together with our customers.

## Specialty Materials Business

---

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell specialty materials used for products such as electronic parts, automobiles, and lenses as precision grindstones, lapping cloth and paper, and polishing agents, filling materials, or the like for lapping, polishing, and blasting. Utilizing technologies for controlling particle size distribution and particle shape as well as other powder technologies, we even draw out potential customer needs by appropriately responding to customer requests, and this in turn improves customer trust. Further, we seek to discover new applications for abrasive grains by reinforcing our technological capabilities.

### Research and Development Activities

We have been developing polishing agents and microparticles for raw materials of the polishing agents suitable for various surfaces, such as LT/LN, plastic lenses and glass. To grasp customer's requirements accurately, we promote the development of products that can satisfy customers by utilizing our core technologies.

## 新規事業

### 事業概要

既存事業以外のさまざまな新規用途で用いられる、多種多様な材料（金属、樹脂、セラミック、複合材料など）や形状（2次元、3次元形状）に対応した研磨材等を製造販売する事業です。世界のさまざまな業界のお客様から寄せられる、新たな表面創成のご要望に、研磨材のみならず用途に応じた周辺消耗材や装置までも含めたトータルソリューションでお応えしてまいります。

### 研究開発活動

素材金属、セラミック、樹脂から複合材料にいたる多種多様な素材、またさまざまな形状に適した研磨材等の開発に取り組んでおります。新規用途では、研磨材のみならず、用途に応じた装置や周辺消耗材の推奨も含めた、加工プロセスの開発・提供も必要とされております。最先端の表面創成ウォンツに、トータルソリューションでお応えし、新規市場開拓を推進してまいります。

さまざまな産業		
 電子部品	 照明 / LED	 自動車
 レンズ	 パワー半導体	etc その他
さまざまな課題		
切断	切削	研削
粗研磨	仕上研磨	etc その他
さまざまな加工対象		
 金属	 プラスチック	 ガラス / 水晶
 サファイア / セラミックス	 化合物半導体	etc その他

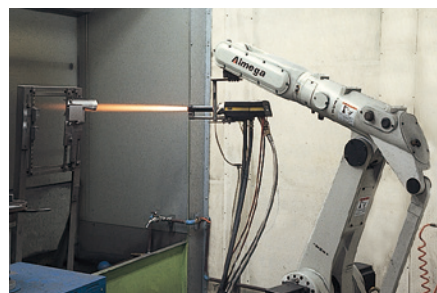
## 溶射材事業

### 事業概要

鉄鋼、航空機および半導体等さまざまな業界における長寿命化、高機能化を実現するために、環境に優しい表面処理として使用される溶射用途向けに、主にサーメット、セラミックスなどの粉末溶射材を製造販売する事業です。粉末造粒技術を強化し、タイムリーなソリューション提案を行うとともに、3Dプリンター用材料等の新規市場開拓による売上拡大を目指してまいります。

### 研究開発活動

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高機能皮膜への要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が期待されております。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めております。これら市場の期待に応えるべく、複合造粒技術やスラリー化技術などを活かした最適な溶射材の開発に重点を置き推進してまいります。また、3Dプリンター用材料の開発と積層成型技術に関する研究を加速させております。



## 先端技術研究所

### 研究所概要

先端技術研究所は、1) 基幹技術開発（基盤技術を強化し深耕、新規技術の開発）、2) 開発企画（新規事業機会の創出と育成）、3) 事業企画（M&A、ベンチャー企業投資の実行と推進）の3つを遂行するため2015年4月に設立しました。それ以降、展示会や学会、大学、公的な研究機関などと連携活動を活性化し、“パウダー&サーフェス”分野での新規事業に結びつくテーマ探索に努めてまいりました。それら活動の結果、現在は非半導体・非研磨分野において、幾つかの新規研究開発テーマで外部との共同開発を開始しております。



さらに2015年11月にベンチャー投資組合を設立し、設立からこれまで有望なベンチャー企業4社への投資を実行しました。本年もこれらの活動を推進し、新規事業の創出に努めてまいります。

## New Business

### Business Overview

In this business, we manufacture and sell abrasives and other products for a wide variety of materials (metal, resin, ceramic, and composite materials) and shapes (two-dimensional and three-dimensional) for new applications other than those covered by existing business. We will continue to serve the new surfacing requests of customers from all walks of industry by providing not only abrasives but also total solutions, including the recommendation of application-specific equipment and consumables.

### Research and Development Activities

We are developing abrasives and other products for metal, ceramic, and composite materials resin for new applications (e.g., LEDs, displays, mobile device, etc.) other than semiconductor, hard disk and other applications covered by existing business. To speak to new applications, on top of abrasive products, development and provision of total manufacturing process are also necessary along with the recommendation of application-specific equipment and consumables. We will provide total solutions for the requests of state-of-the-art surface creating, which develops new markets.



## Thermal Spray Materials Business

### Business Overview

In this business, we mainly manufacture and sell powdered thermal spray materials such as cermets and ceramics for thermal spray applications, which is environmental-friendly surface processing, in order to meet the demand for longer product life and higher product functions in a variety of industries including iron and steel, aircraft, and semiconductors. We aim to increase sales by reinforcing our powder granulation technologies, promptly offering solutions, and developing new markets such as materials for 3D printers.

### Research and Development Activities

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is a growing need for highly functional films across a wide range of products, such as aircrafts, semiconductors and general industrial equipment; thus, broader use of thermal spray films is expected. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are "lower temperatures" and "micronization," as means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of appropriate thermal spray materials by applying our compounding, granulation and slurring technologies.

## Advanced Technology Research Center

### Institute Overview

The Advanced Technology Research Center was established in April 2015 in order to achieve the following three tasks: (1) Develop foundational technology (strengthens and deepens core technologies while also developing new technology); (2) Plan development (creates and fosters new business opportunities); and (3) Plan businesses (execute and promote M&A and venture business investments). Since then, we have been striving to explore themes that can connect to new businesses in the powder and surface fields by actively promoting exhibitions, academic conferences and collaborative activities with universities and public institutions. As a result of such activities, we have now begun joint development with external companies on new research and development themes in multiple fields regarding non-semiconductors and nonabrasives.

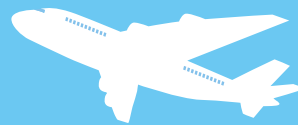
Furthermore, we established a venture investment fund in November 2015, and invested in four high-potential venture companies since establishment to now.

This year, we will continue to promote these activities and make an effort to have new businesses.

# 暮らしの中のフジミ

## Fujimi's Products and Technology in Everyday Life

フジミの製品は、生活の中のさまざまな物に使われています。  
Fujimi's products are used for various items that people see and use in everyday life.



### 飛行機 Aircraft

ココにも



フラップ・スラット  
レールに溶射材が  
使われています。

Thermal Spray materials  
are used for flap-slat  
rails.



### ココにも FUJIMI 鉄道 Railroads

車両の中の IC チップ製造  
過程で FO、GLANZOX、  
PLANERLITE 等が使われ  
ています。

FO, GLANZOX and  
PLANERLITE are used for  
manufacturing process of  
IC chips placed in rolling  
stock.



### 信号機 Traffic lights

ココにも  
FUJIMI

サファイア基板を  
磨く過程で COMPOL  
が使われています。

COMPOL is used for  
manufacturing process  
of sapphire substrates  
placed in LED lamps.



### ココにも FUJIMI スマートフォン Smartphones

部品の中の水晶振動子  
製造過程で GC が使われ  
ています。

GC is used for manufacturing  
process of crystal oscillators  
placed in smartphones.

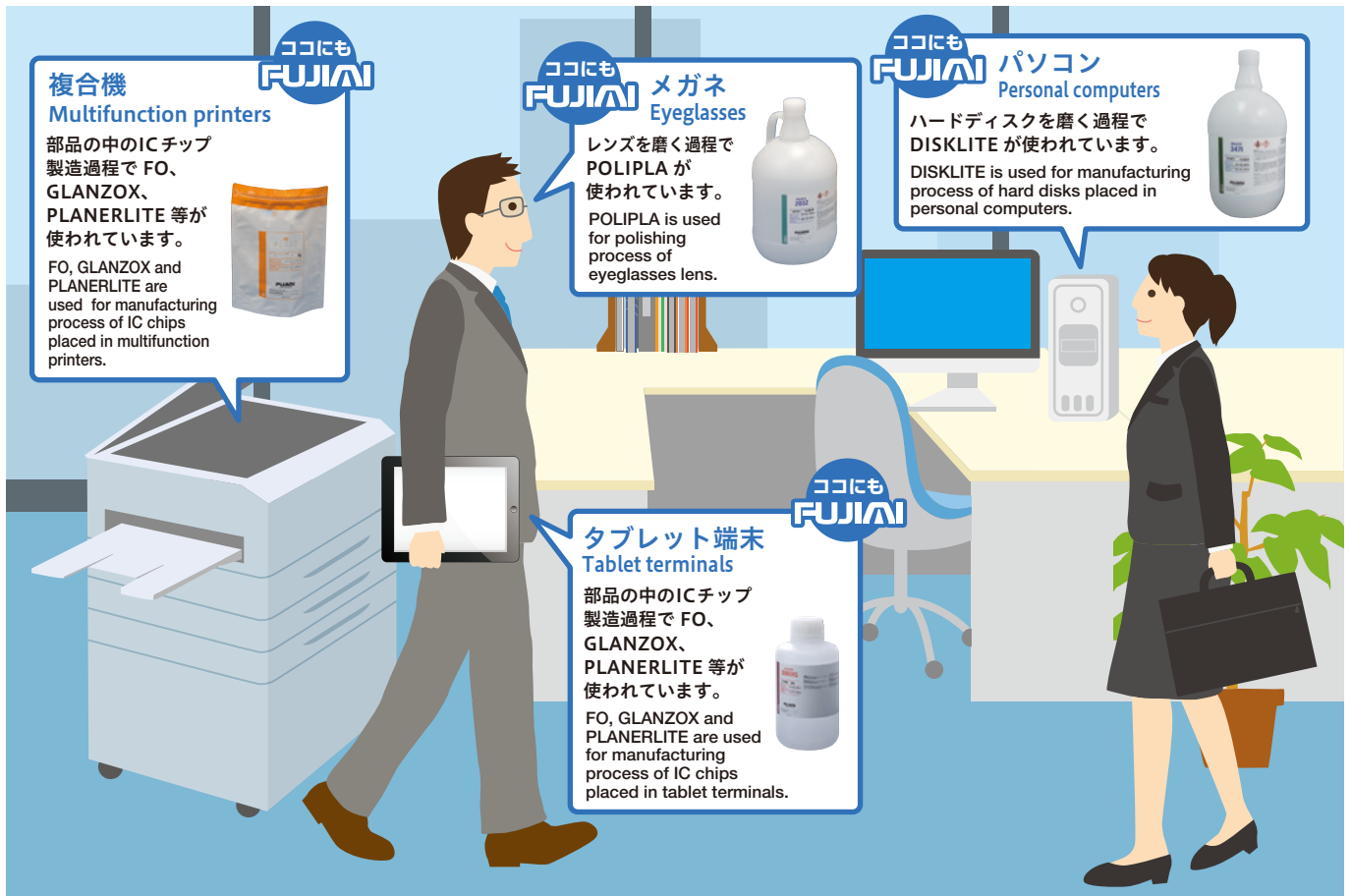


### ココにも FUJIMI 自動車 Automobiles

ボディを磨くのに  
GC、WA が使われています。

GC and WA are used for  
polishing process of  
automobile bodies.





**複合機**  
Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in multifunction printers.



**メガネ**  
Eyeglasses

レンズを磨く過程で POLIPLA が使われています。  
POLIPLA is used for polishing process of eyeglasses lens.



**パソコン**  
Personal computers

ハードディスクを磨く過程で DISKLITE が使われています。  
DISKLITE is used for manufacturing process of hard disks placed in personal computers.



**タブレット端末**  
Tablet terminals

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in tablet terminals.



**デジタル TV**  
Digital TVs

部品の中の IC チップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips of digital TVs.



**LED ライト** LED lights

サファイア基板を磨く過程で COMPOL が使われています。  
COMPOL is used for manufacturing process of sapphire substrates placed in LED lights.



**デジタルカメラ**  
Digital cameras

部品の中の IC チップ製造過程で FO、GLANZOX、PLANERLITE 等が使われています。  
FO, GLANZOX and PLANERLITE are used for manufacturing process of IC chips placed in digital cameras.



**楽器**  
Musical instruments

ギターやピアノなどの表面を磨くために GC、WA が使われています。  
GC and WA are used for manufacturing process of pianos, guitars, etc.

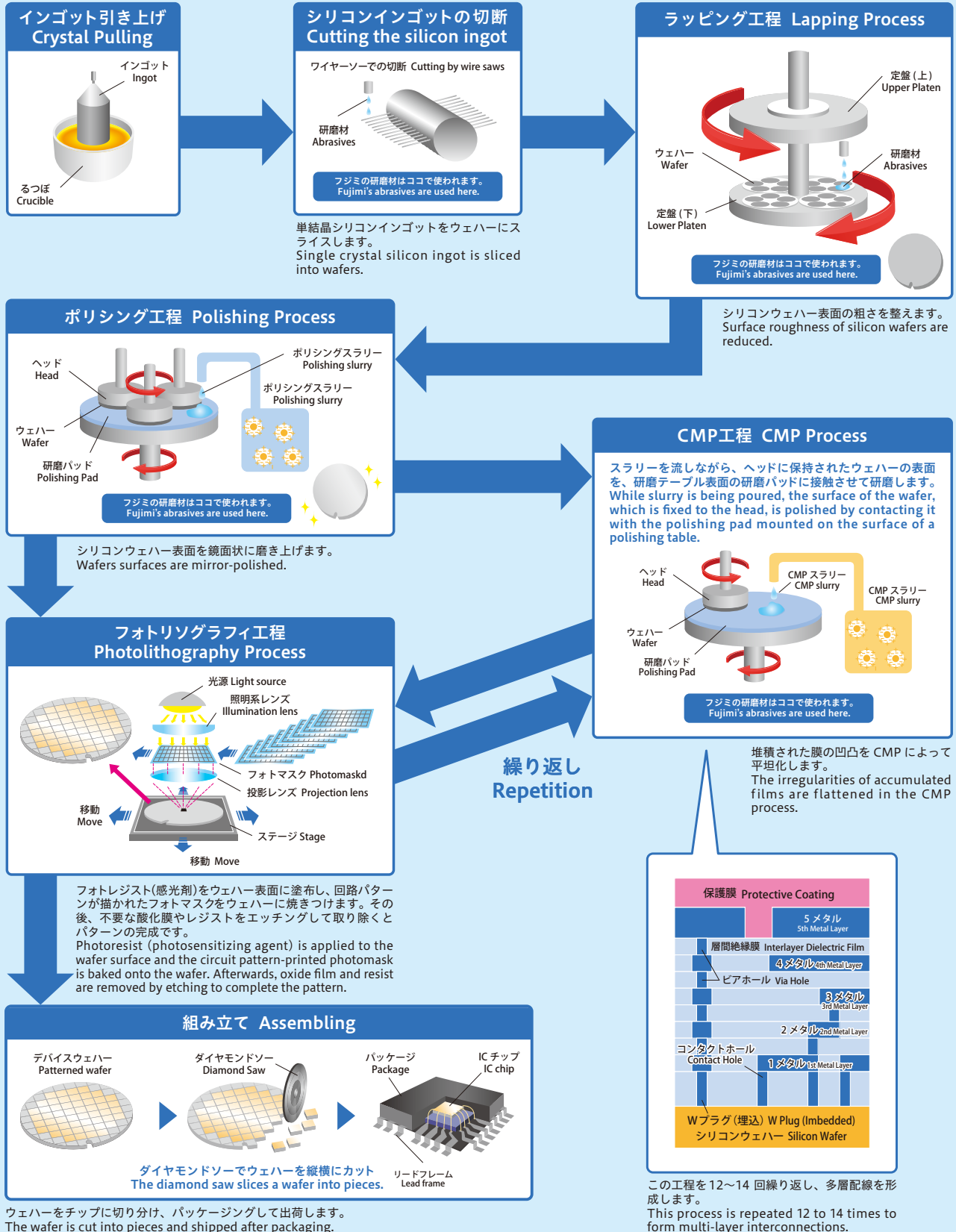


# 製造工程の中のフジミ

## Fujimi's Products in Manufacturing Process

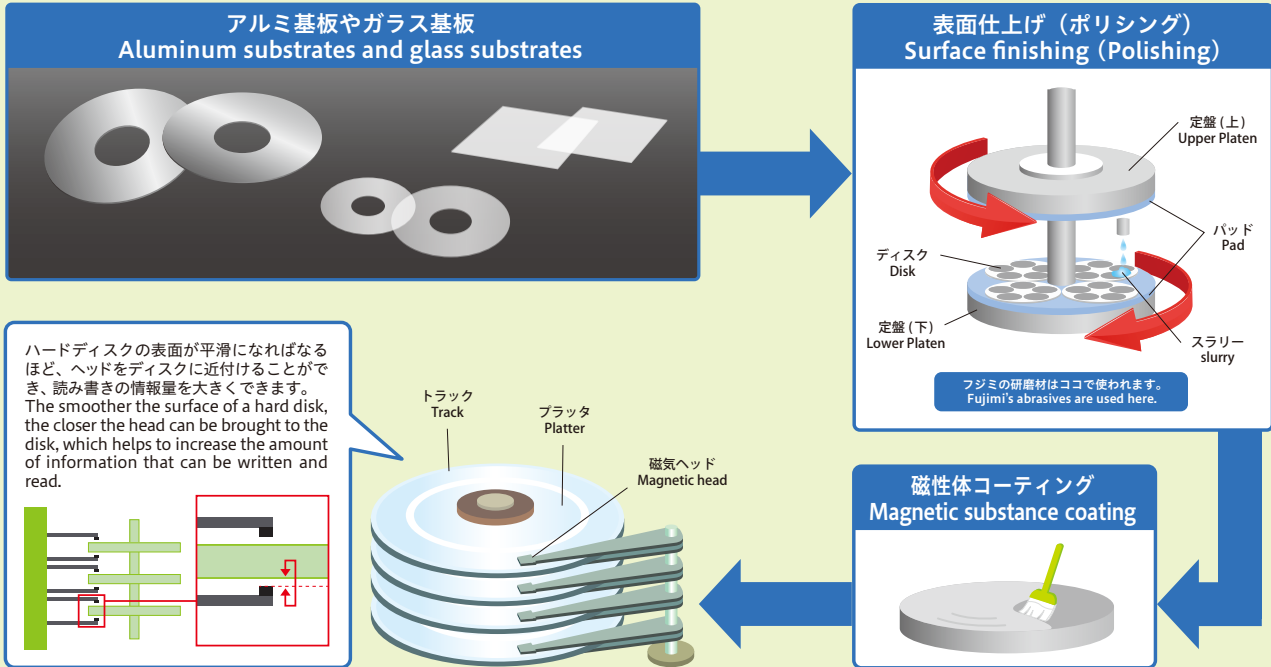
### 半導体デバイス製造に使われるフジミの製品

### Fujimi's products used for semiconductor device production

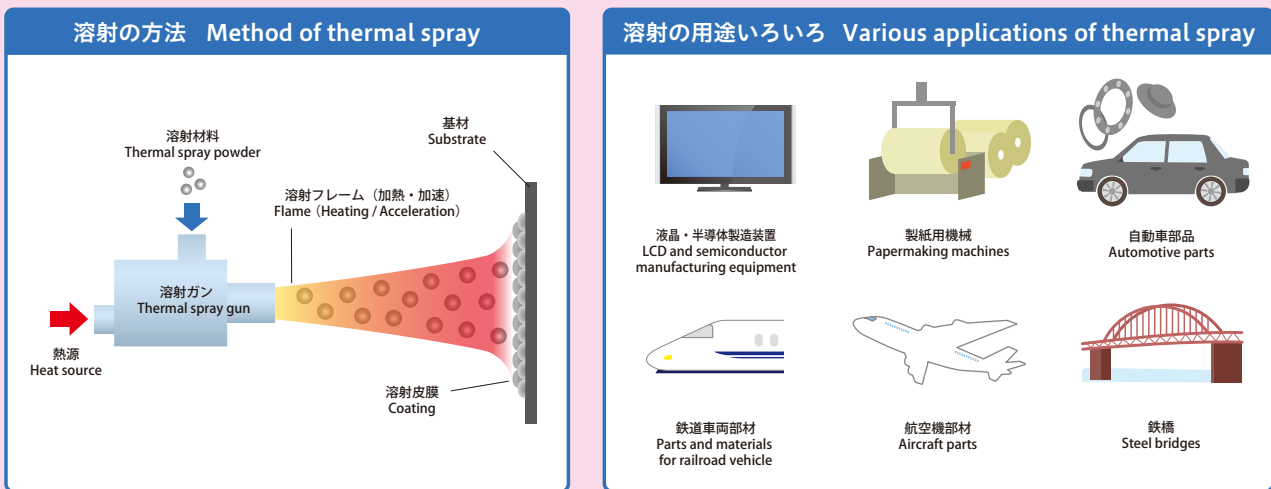


※イラストはイメージです。実際の工程とは異なることもあります。  
 The illustrations are only example images. The actual process may vary from the illustrations.

## ハードディスクの構造 Structure of hard disks



## 溶射と色々な用途 Thermal spray and various applications



溶射材料を溶射フレームに投入し、基材へ衝突、堆積させることで機能性皮膜を作製する。  
Thermal spray powder is supplied into the flame, then deposited on the substrate to form functional coatings.

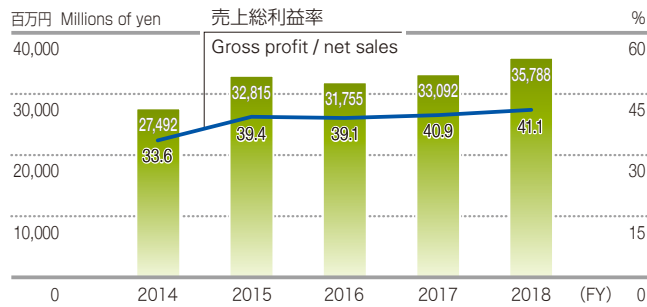
過酷な条件下で使用される機械部品や構造物を熱や腐食、摩耗から守り、長持ちさせる目的で使われる溶射材。その用途は、鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋など多岐にわたっています。  
Thermal spray is used to protect machine parts and structures that are used under extreme conditions against heat, corrosion, and abrasion, and to make them durable. Thermal spray is applied to a variety of fields including railroads, LCD and semiconductor manufacturing equipment, gas turbines for power generation, papermaking machines and steel bridges.

# 経営指標 Selected Financial Data

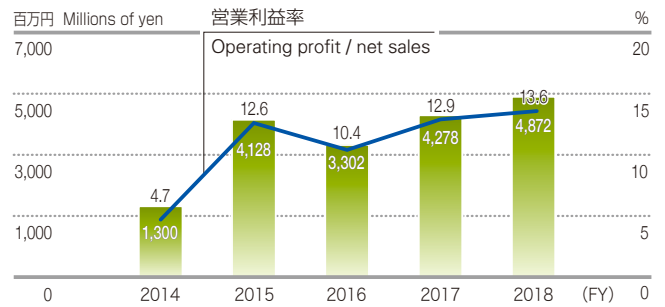
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

## 収益性 Profitability

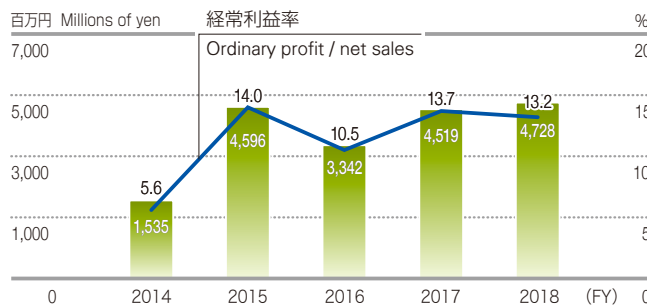
### 売上高/売上総利益率 Net Sales and Gross Profit / Net Sales



### 営業利益/営業利益率 Operating Profit and Operating Profit / Net Sales



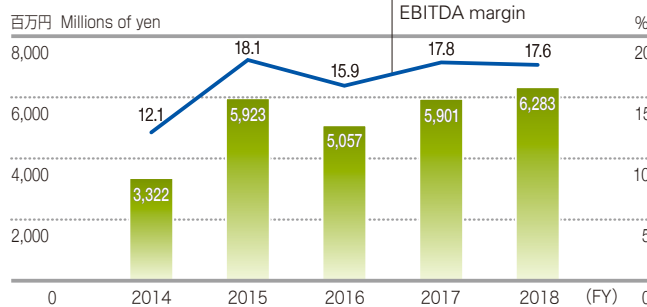
### 経常利益/経常利益率 Ordinary Profit and Ordinary Profit / Net Sales



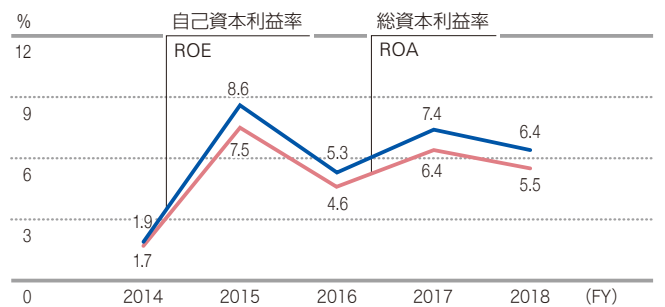
### 親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益率 Profit Attributable to Owners of Parent and Return on Sales



### EBITDA/EBITDAマージン EBITDA/EBITDA Margin



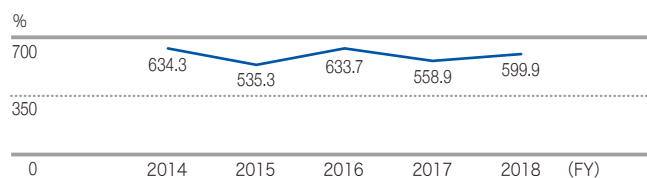
### 自己資本利益率/総資本利益率 Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



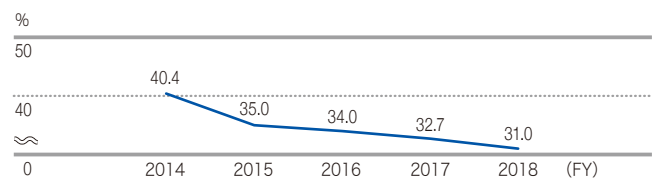
3月31日終了の各事業年度  
Fiscal years ended March 31

## 安定性 Stability

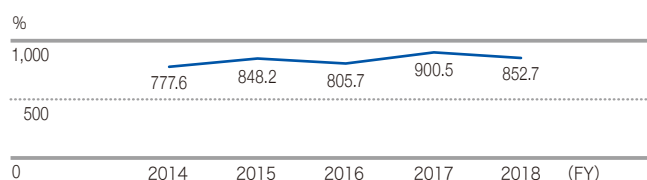
### 流動比率 Current Ratio



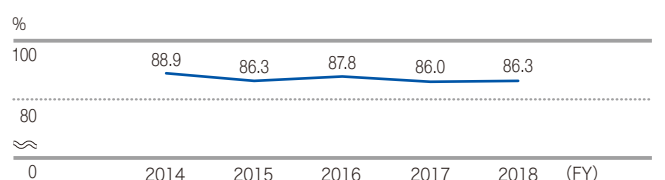
### 固定比率 Non-current Assets Ratio



### 手元流動性比率 Short-Term Liquidity

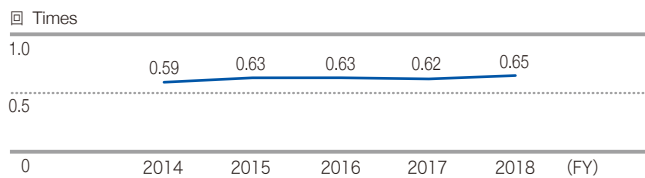


### 自己資本比率 Equity Ratio

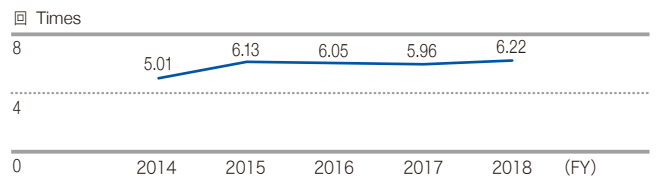


## 生産性／効率性 Productivity and Efficiency

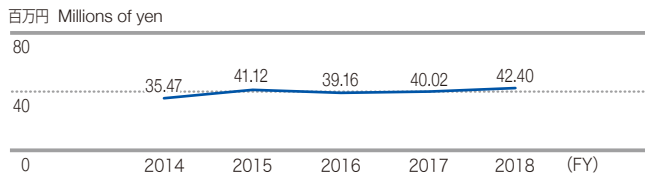
### 総資本回転率 Total Asset Turnover



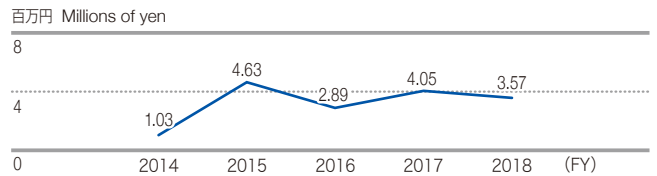
### たな卸資産回転率 Inventory Turnover



### 従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee

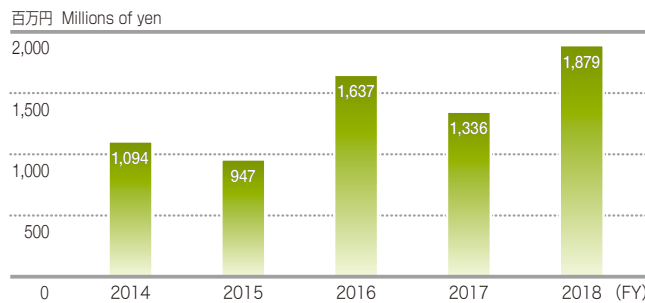


### 従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee

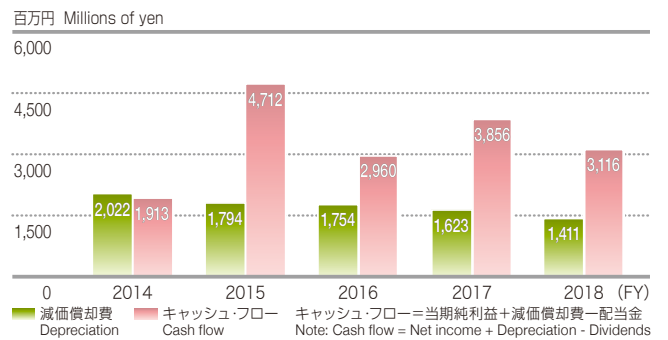


## 設備投資／研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

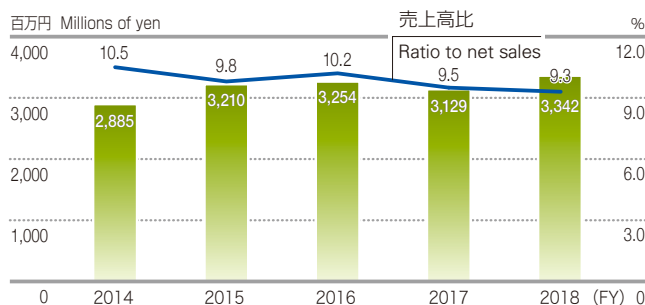
### 設備投資 Capital Expenditures



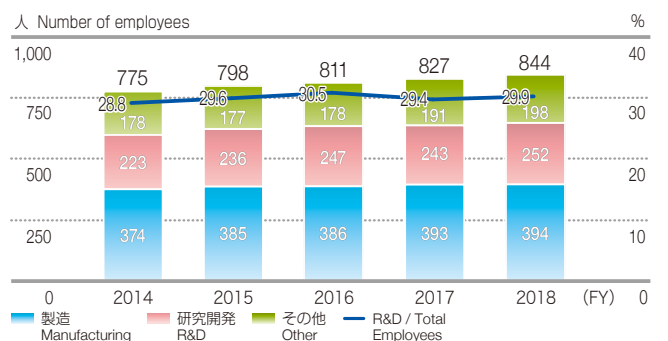
### 減価償却費/キャッシュ・フロー Depreciation and Cash Flow



### 研究開発費/売上高比 R&D Expenses and Ratio to Net Sales

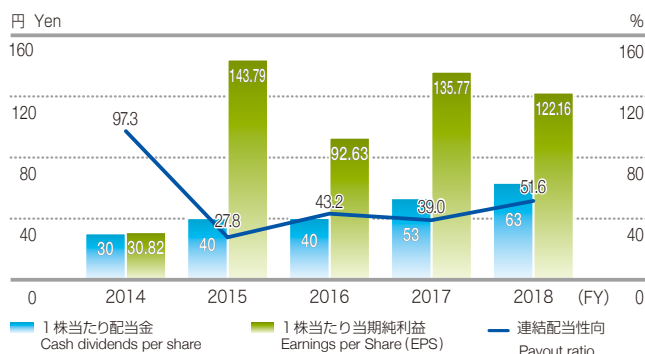


### 研究開発要員 Number of Employees - R&D / Total -

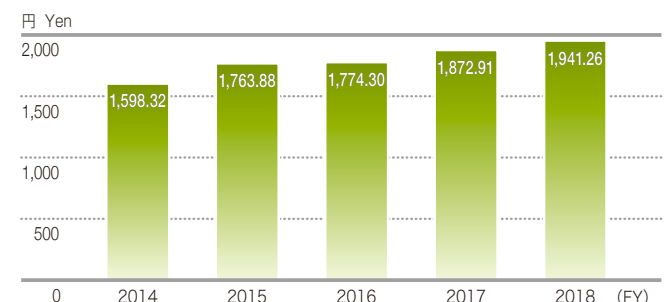


## 投資指標 Per Share Data and Others

### 1株当たり配当金/1株当たり当期純利益/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Earnings per Share (EPS), Payout Ratio



### 1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



# 連結貸借対照表

## Consolidated Balance Sheet

		百万円 Millions of yen				
		各年 3月31日現在 As of March 31				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>資産の部</b>	<b>Assets</b>					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	12,709	18,390	19,320	24,332	<b>24,929</b>
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable-trade	5,780	6,487	6,669	7,239	<b>8,010</b>
有価証券	Securities	5,106	4,805	1,999	500	<b>500</b>
たな卸資産	Inventories	5,107	5,606	5,383	5,721	<b>5,793</b>
繰延税金資産	Deferred tax assets	393	690	448	544	<b>612</b>
その他	Other	825	182	1,713	302	<b>772</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(25)	(28)	(11)	(17)	<b>(23)</b>
流動資産合計	Total current assets	29,898	36,134	35,525	38,623	<b>40,596</b>
固定資産	Non-current assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物（純額）	Buildings and structures, net	7,779	7,913	7,341	7,262	<b>7,822</b>
機械装置及び運搬具（純額）	Machinery, equipment and vehicles, net	1,665	1,384	1,027	1,105	<b>1,483</b>
土地	Land	3,410	3,425	3,418	3,418	<b>3,119</b>
建設仮勘定	Construction in progress	167	120	809	1,070	<b>302</b>
その他（純額）	Other, net	1,547	1,302	1,081	778	<b>621</b>
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	14,570	14,146	13,680	13,635	<b>13,349</b>
無形固定資産	Intangible assets	593	710	686	509	<b>479</b>
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	126	247	525	709	<b>744</b>
繰延税金資産	Deferred tax assets	176	154	164	120	<b>142</b>
その他	Other	1,515	522	112	109	<b>141</b>
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(232)	(124)	(9)	(9)	<b>(9)</b>
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	1,586	799	793	930	<b>1,019</b>
固定資産合計	Total non-current assets	16,750	15,656	15,159	15,075	<b>14,849</b>
資産合計	Total assets	46,648	51,790	50,684	53,699	<b>55,445</b>

百万円 Millions of yen

		各年 3月31日現在 As of March 31				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>負債の部</b>	<b>Liabilities</b>					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable - trade	2,713	3,319	2,703	3,226	3,269
未払法人税等	Income taxes payable	56	763	263	866	429
賞与引当金	Provision for bonuses	554	947	785	1,002	1,115
その他	Other	1,389	1,719	1,853	1,815	1,952
流動負債合計	Total current liabilities	4,713	6,750	5,605	6,911	6,767
固定負債	Non-current liabilities					
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	13	13	8	7	5
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	389	311	526	579	651
その他	Other	23	20	19	37	172
固定負債合計	Total non-current liabilities	427	345	554	623	829
負債合計	Total liabilities	5,140	7,096	6,160	7,535	7,597
<b>純資産の部</b>	<b>Net assets</b>					
株主資本	Shareholders' equity					
資本金	Capital stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,069	5,038	5,038	5,038	5,570
利益剰余金	Retained earnings	37,052	38,836	40,042	41,013	42,718
自己株式	Treasury shares	(5,711)	(5,379)	(5,725)	(5,108)	(5,641)
株主資本合計	Total shareholders' equity	41,163	43,248	44,109	45,697	47,401
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	295	1,446	414	466	446
新株予約権	Subscription rights to shares	48	—	—	—	—
純資産合計	Total net assets	41,507	44,694	44,523	46,164	47,848
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	46,648	51,790	50,684	53,699	55,445

# 連結損益計算書

## Consolidated Statement of Income

		百万円 Millions of yen				
		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2014	2015	2016	2017	2018
売上高	Net sales	27,492	32,815	31,755	33,092	<b>35,788</b>
売上原価	Cost of sales	18,262	19,887	19,353	19,568	<b>21,081</b>
売上総利益	Gross profit	9,230	12,927	12,402	13,524	<b>14,706</b>
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	7,929	8,799	9,099	9,246	<b>9,834</b>
営業利益	Operating profit	1,300	4,128	3,302	4,278	<b>4,872</b>
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	62	46	28	25	<b>59</b>
その他	Other	215	459	68	247	<b>76</b>
営業外収益合計	Total non-operating income	277	506	97	273	<b>135</b>
営業外費用	Non-operating expenses	42	39	58	31	<b>279</b>
経常利益	Ordinary profit	1,535	4,596	3,342	4,519	<b>4,728</b>
特別利益	Extraordinary profit	3	48	—	—	<b>—</b>
特別損失	Extraordinary losses	253	—	—	18	<b>568</b>
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	1,285	4,645	3,342	4,500	<b>4,160</b>
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	384	1,287	733	1,282	<b>1,240</b>
法人税等調整額	Income taxes—deferred	100	(338)	262	(132)	<b>(91)</b>
親会社株主に帰属する当期純利益	Profit attributable to owners of parent	799	3,695	2,346	3,350	<b>3,011</b>

# 連結包括利益計算書

## Consolidated Statement of Comprehensive Income

		百万円 Millions of yen				
		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2014	2015	2016	2017	2018
当期純利益	Profit	799	3,695	2,346	3,350	<b>3,011</b>
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities	2	85	(11)	132	<b>(52)</b>
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment	680	1,048	(920)	(124)	<b>(7)</b>
退職給付に係る調整額	Remeasurements of defined benefit plans, net of tax	—	17	(100)	44	<b>39</b>
その他の包括利益合計	Total other comprehensive income	682	1,151	(1,031)	52	<b>(19)</b>
包括利益	Comprehensive income	1,482	4,846	1,314	3,402	<b>2,991</b>
(内訳)	Breakdown					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent	1,482	4,846	1,314	3,402	<b>2,991</b>

# 連結キャッシュ・フロー計算書

## Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		3月31日終了の各事業年度 Fiscal years ended March 31				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from operating activities</b>					
税金等調整前当期純利益	Profit before income taxes	1,285	4,645	3,342	4,500	4,160
減価償却費	Depreciation	2,022	1,794	1,754	1,623	1,411
減損損失	Impairment loss	253	—	—	—	568
売上債権増減額（増加）	Decrease (increase) in notes and accounts receivable - trade	394	(495)	(421)	(669)	(735)
仕入債務増減額（減少）	Increase (decrease) in notes and accounts payable - trade	(608)	442	(421)	570	2
たな卸資産増減額（増加）	Decrease (increase) in inventories	945	(281)	23	(398)	(67)
その他	Other	(813)	332	14	614	(62)
小計	Subtotal	3,479	6,438	4,291	6,241	5,275
利息及び配当金の受取額	Interest and dividend income received	77	57	38	31	56
法人税等の支払額	Income taxes paid	(2,512)	(644)	(1,519)	(779)	(1,700)
法人税等の還付額	Income taxes refund	—	641	59	291	39
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) operating activities	1,044	6,491	2,869	5,785	3,671
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from investing activities</b>					
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(2,223)	(3,719)	—	—	(4,243)
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	2,517	3,993	2,969	—	2,217
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	(4,107)	(2,800)	(2,999)	—	—
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	4,100	3,602	3,300	1,500	—
有形固定資産の取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(1,597)	(722)	(990)	(1,531)	(1,741)
その他	Other	(139)	(31)	(655)	(7)	(114)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) investing activities	(1,450)	322	1,623	(38)	(3,882)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>Cash flows from financing activities</b>					
配当金の支払額	Cash dividends paid	(907)	(778)	(1,140)	(1,118)	(1,306)
自己株式の取得	Purchase of treasury shares	—	(901)	(345)	(644)	—
その他	Other	(8)	(7)	(1,159)	1,154	(1)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by (used in) financing activities	(916)	(1,687)	(2,644)	(608)	(1,308)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	303	309	(453)	(127)	23
現金及び現金同等物の増加（減少）額	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(1,019)	5,436	1,394	5,011	(1,496)
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	14,009	12,990	18,426	19,820	24,832
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	12,990	18,426	19,820	24,832	23,336

日付	内容	Date	Event
1950年8月	不二見研磨材工業所を創立し、人造精密研磨材の生産を開始	August 1950	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953年3月	不二見研磨材工業株式会社を設立	March 1953	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957年	東京通信工業(株)(現ソニー(株))のゲルマニウム半導体基板用研磨材ニーズに対応	1957	Supplied lapping abrasives for germanium semiconductor substrates to Tokyo Tsushin Kogyo, the predecessor of Sony Corporation.
1967年7月	シリコンウェハー用ポリシング材 [GLANZOX] を発表	July 1967	Announced the development of GLANZOX polish for silicon wafers.
1977年1月	プラスチックレンズ用研磨材 [POLIPLA] を生産開始	January 1977	Began manufacturing POLIPLA plastic lens polishing compounds.
1981年	[COMPOL] シリーズを開発	1981	Developed the "COMPOL" series.
1990年11月	ディスク用ポリシング材 [DISKLITE] シリーズを開発	November 1990	Developed the DISKLITE series, the first polishing compounds developed especially for memory disks.
1995年4月	CMP用スラリー [PLANERLITE] シリーズを開発	April 1995	Developed the PLANERLITE series of CMP slurries.
2001年1月	耐衝撃 WC サーメット溶射材 [SURPREX W2010X] を発表	January 2001	Introduced the SURPREX-W2010X, new WC cermet thermal spraying composites of enhanced impact resistance.
2002年3月	FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2002	FUJIMI AMERICA INC.* won the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2002年10月	世界初、HVOF [高速フレイム溶射] による微粉末溶射システムの確立に成功	October 2002	Successfully developed the world's first ultra-fine-grain thermal spray system employing a high velocity oxy-fuel (HVOF) process.
2003年3月	当社およびFUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2003	FUJIMI INCORPORATED and FUJIMI AMERICA INC.* received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2004年3月	FUJIMI CORPORATION が、インテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インブルーメント (SCQI) 賞」を受賞	March 2004	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2007年2月	東証一部、名証一部に同時上場	February 2007	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section.
2008年7月	FUJIMI CORPORATION が AMD 社の「World Class Supplier Pathfinder Award 2007」を受賞	July 2008	FUJIMI CORPORATION received the World Class Supplier Pathfinder Award 2007 from AMD.
2009年11月	研磨に適した新しい粒子「角状ナノアルミナ」の開発に成功	November 2009	Successfully developed "angular nano-aluminium" as an abrasive material.
2010年3月	世界初、500℃から成膜可能な超硬溶射材の開発に成功	March 2010	Successfully developed the world's first tungsten carbide powders applicable to low temperature spray processes of 500℃.
2011年4月	航空・宇宙・防衛 品質マネジメントシステム (JIS Q 9100) 認証を取得 (溶射材)	April 2011	Obtained JIS Q 9100 quality management certification for aircraft, space and defense (for thermal spray materials).
2013年12月	TSMC 社の「Excellent Performance Award (優秀賞)」を受賞	December 2013	FUJIMI INCORPORATED received the Excellent Performance Award from TSMC.
2015年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2015	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2016年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2016	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2017年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インブルーメント (SCQI) 賞」を受賞	March 2017	FUJIMI CORPORATION received the Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2018年3月	FUJIMI CORPORATION がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー (PQS) 賞」を受賞	March 2018	FUJIMI CORPORATION received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.

\* FUJIMI AMERICA INC. は 2003年7月にFUJIMI CORPORATION と合併し、商号をFUJIMI CORPORATION に変更しました。

\* FUJIMI AMERICA INC. merged with FUJIMI CORPORATION in 2003 July, and changed the corporate name to FUJIMI CORPORATION.

# 株式情報 Stock Information

## 大株主一覧 Leading Shareholders

2018年3月31日現在 As of March 31, 2018

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 <sup>*1</sup> (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 <sup>*1</sup> (%) Shareholding ratio
有限会社コマ	Koma Co.,Ltd.	3,743	13.0
株式会社フジミインコーポレーテッド	FUJIMI INCORPORATED (Treasury Stock)	3,667	12.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trust account)	1,409	4.9
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	Japan Trustee Services Bank, Ltd.(Trust account)	1,087	3.7
株式会社三菱東京UFJ銀行 <sup>*2</sup>	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	717	2.4
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	639	2.2
フジミ取引先持株会	The Koshiyama Science and Technology Foundation	632	2.2
一般財団法人越山科学技術振興財団	Nippon Life Insurance Co.	600	2.0
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRAD AC ISG (FE-AC)	BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRAD AC ISG (FE-AC)	597	2.0

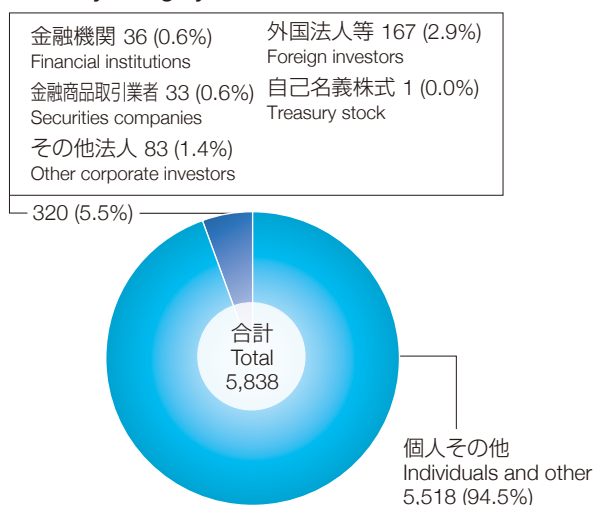
\*1 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。  
Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.

\*2 株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日より株式会社三菱UFJ銀行へ名称を変更しております。  
"The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd." has changed its name to "MUFG Bank, Ltd." as of April 1, 2018.

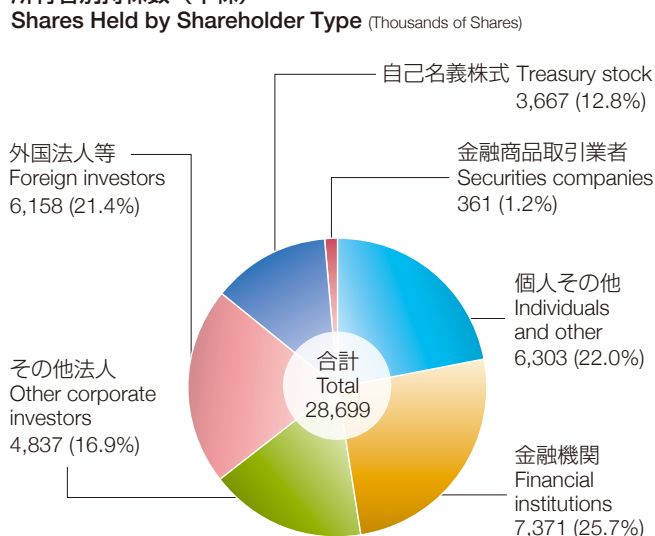
## 所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2018年3月31日現在 As of March 31, 2018

### 所有者別株主数 (人) Shareholders by Category (Number of Shareholders)



### 所有者別持株数 (千株) Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



## 発行済株式の推移 Common Stock Issues

日付 Date	摘要 Type of Issue	発行済株式数 (千株) Shares Outstanding (Thousands of Shares)
1992年 2月 1日 February 1, 1992	第三者割当増資 Allotment of new shares to third parties	245
1992年 11月 20日 November 20, 1992	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	491
1993年 9月 27日 September 27, 1993	新株引受権の権利行使 Exercise of warrants	509
1994年 5月 20日 May 20, 1994	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	1,019
1994年 8月 4日 August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割 Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年 4月 18日 April 18, 1995	一般公募増資 Public offering of common stock	10,995
1996年 5月 20日 May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	12,094
1996年 10月 1日 October 1, 1996	一般公募増資 Public offering of common stock	12,894
1997年 5月 20日 May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	14,184
1998年 5月 20日 May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割 (無償) 1.1-for-1 stock split	15,602
2001年 11月 22日 November 22, 2001	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	15,349
2005年 5月 20日 May 20, 2005	1株につき2株の株式分割 (無償) 2-for-1 stock split	30,699
2014年 11月 4日 November 4, 2014	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	29,699
2016年 6月 15日 June 15, 2016	自己株式の消却 Retirement of treasury stock	28,699

# 会社データ

## Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	844 (単体 Non-Consolidated 580)

## 役員 Board of Directors

2018年6月22日現在 As of June 22, 2018

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘 Katsuhiko Suzuki
取締役 Director	川下 政美* Masami Kawashita
取締役 Director	浅井 侯序* Yoshitsugu Asai
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦** Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	岡野 勝** Masaru Okano

(\*印は社外取締役)  
(\*\*印は社外監査役)

Note: \* indicates outside directors  
\*\* indicates outside corporate auditors

## 事務所・拠点 Plants and Offices

### 本社・枇杷島工場

Headquarters / Biwajima Plant

〒452-8502  
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1  
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166  
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu,  
Aichi 452-8502, Japan  
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

### 溶射材事業部

Thermal Spray Materials Department

〒509-0103  
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28  
82-28, Kakamihigashimachi-5,  
Kakamigahara,  
Gifu 509-0103, Japan

### 東京事務所

Tokyo Office

〒101-0047  
東京都千代田区内神田 3-2-8  
いちご内神田ビル 7F  
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8,  
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo 101-0047, Japan

### 稲沢工場

Inazawa Plant

〒492-8329  
愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1  
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa,  
Aichi 492-8329, Japan

### 研究開発センター

R&D Center

〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8  
8, Technoplaza-1, Kakamigahara,  
Gifu 509-0109, Japan

### 上海事務所

Shanghai Office

上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室  
317B, German Center, 88 Keyuan Road,  
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203,  
Shanghai, China

### 各務原工場

Kakamigahara Plant

〒504-0927  
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8  
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara,  
Gifu 504-0927, Japan

### 先端技術研究所

Advanced Technology Research Center

〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-22  
22, Technoplaza-1, Kakamigahara,  
Gifu 509-0109, Japan

### 各務東町工場

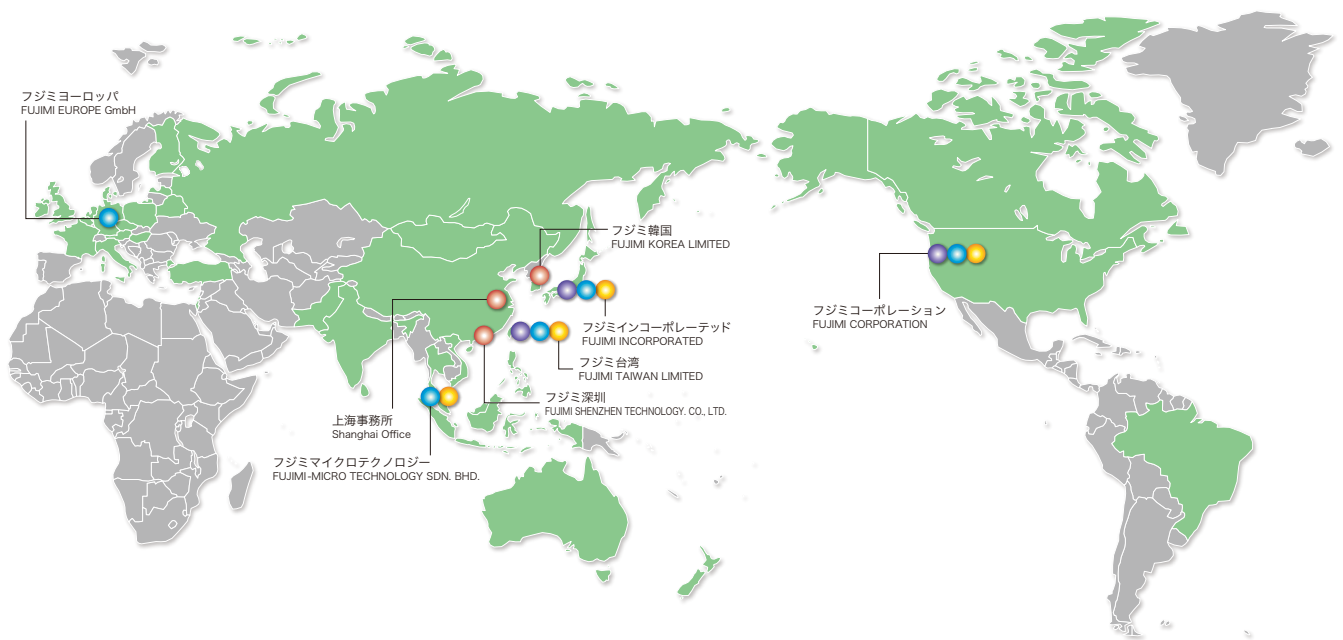
Kakamihigashimachi Plant

〒509-0103  
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1  
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,  
Gifu 509-0103, Japan

### 物流センター

Logistics Center

〒509-0109  
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1  
1, Technoplaza-4, Kakamigahara,  
Gifu 509-0109, Japan



- 開発拠点  
 Development base
- 販売拠点  
 Sales offices
- 生産拠点  
 Production facilities
- サポートセンター  
 Support center
- 販売先国  
 Product sold countries

## 連結子会社 Consolidated subsidiary

### フジミコーポレーション (米国) FUJIMI CORPORATION

11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A.  
 Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

### フジミ台湾 (台湾) FUJIMI TAIWAN LIMITED

No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township, Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)  
 Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

### フジミマイクロテクノロジー (マレーシア) FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.

Lot 13, Jalan Hi-Tech 3, Industrial Zone Phase 1  
 Kulim Hi-Tech Park, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman, Malaysia  
 Phone: +60-4-403-3700 Fax: +60-4-403-3900

### フジミ韓国 (韓国) FUJIMI KOREA LIMITED

RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, Bundang-Gu, Seongnam-Shi,  
 Kyeonggi-Do, Korea  
 Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

### フジミヨーロッパ (ドイツ) FUJIMI EUROPE GmbH

Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany  
 Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

### フジミ深圳 (中国) FUJIMI SHENZHEN TECHNOLOGY. CO., LTD.

13G-1, South Maple Building, Nanshan District, Shenzhen 518054,  
 China  
 Phone: +86-755-2267-5151 Fax: +86-755-2267-5162

# FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。

Copyright (C) 2018 Fujimi Incorporated. All rights reserved.  
Printed in Japan